

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 3 区分

【発行日】平成23年8月18日(2011.8.18)

【公表番号】特表2009-542450(P2009-542450A)

【公表日】平成21年12月3日(2009.12.3)

【年通号数】公開・登録公報2009-048

【出願番号】特願2009-518460(P2009-518460)

【国際特許分類】

**B 2 4 B 53/007 (2006.01)**

**B 2 4 B 37/00 (2006.01)**

**B 2 4 B 53/02 (2006.01)**

**H 0 1 L 21/304 (2006.01)**

【F I】

B 2 4 B 53/007

B 2 4 B 37/00 A

B 2 4 B 53/02

H 0 1 L 21/304 6 2 2 M

【手続補正書】

【提出日】平成23年7月1日(2011.7.1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

研磨パッドをクリーニングするための装置であって、  
 回転可能なプラテンと、  
 上記プラテン上に配設される研磨パッドと、  
 研磨流体を上記研磨パッドから離れるように指向するための上流ディレクタと、  
 上記研磨パッドの上で旋回可能な第 1 の分配アームに取り付けられ、上記上流ディレクタとは別の空気ジェットと、  
 第 2 の分配アームに取り付けられ且つ上記研磨パッドの上に配置される水ジェットと、  
 上記第 2 の分配アームに結合され、上記研磨パッドをコンディショニングするための回転可能なコンディショニングディスクと、  
 を備える装置。

【請求項 2】

上記空気ジェットは、空気ナイフを備える、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 3】

上記研磨パッドは、化学機械研磨パッドである、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 4】

上記研磨パッドは、電気化学機械研磨パッドである、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 5】

上記上流ディレクタは、上記水ジェットの上流に配設される、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 6】

上記ディレクタと上記水ジェットとの間に画成される流体の無いゾーンを更に備える、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 7】

上記流体の無いゾーンは、そこに実質的に全く研摩流体が無い、請求項6に記載の装置。

【請求項 8】

上記上流ディレクタは、ガストリーム、スプレー、真空及びワイパーのうちの少なくとも 1 つを備える、請求項1に記載の装置。

【請求項 9】

研摩流体分配ノズルが上記第 1 の分配アームに結合される、請求項1に記載の装置。